第 1 号議案

平成 21 年度事業報告書

自: 平成 21 年 4 月 1 日　至: 平成 22 年 3 月 31 日

1. 全般

(1) 経済状況の影響により、正会員および賛助会員が大幅に減少した。会費収入確保へ、未納会費の納入依頼を重ねてお願いするとともに、学会運営の経費節減のため、諸活動の効率化と、事務局費用の大幅削減などの施策検討を進めた。

(2) 大会行事や教育事業などイベント参加者も減少傾向となった。対応策として、企画内容の工夫や他学協会との協賛連携など参加勧誘活動を推進するとともに、費用管理および経費節約の見直しを図った。

(3) 実装技術分野の将来を俯瞰し、技術委員会・研究会に世界をリードする新しい方向性を提案するための準備活動として「2020年技術ビジョン策定WG」を組織し検討を進めた。

(4) 会員サービスの充実を図るため、前身の回路実装学会誌などを含め電子アーカイブや電子ジャーナルに掲載し、Webを利用したサービスを充実させた。

(5) 本学会のプレゼンスを高め、国際交流活動を推進するため、日本における実装技術関連で唯一の国際会議ICEP2009の主催、IMAPS との連携におけるWLC－ALC活動およびAffiliate会員制度を継続維持した。さらに、英文論文誌の充実、国際会員番号の創設、韓国語翻訳転載などの施策を実施した。

(6) 関西支部では、関西地区の学協会と共催・協賛の連携をより密にするとともに、支部独自の活動として、若手研究者研究会やセミナーなどの地域活動を積極的に展開した。

2. 国際会議・学術講演大会・展示会等の開催（定款第 4 条第 1 号関係）

(1) 国際会議「ICEP 2009」(組織委員長　ﾆｼﾀﾞｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ実装技術支援　西田秀行氏)

2009.4.14～16、京都国際会館にて、IEEE CPMT Japan Chapter および IMAPS と共催で、 第 13 回の国際会議 「ICEP 2009」 を開催した。海外 54 件 (内、招待講演 3 件) を含む総計 163 件の口頭発表、20 件のポスター発表および国際交流会を開催した。論文集(A4 判・991 頁)を刊行し、357 名(内、海外 83 名)と多くの参加者を集めた。

(2)「2009 最先端実装技術シンポジウム、マイクロエレクトロニクスショー、アカデミックプラザ」

2009.6.3～5、最先端実装技術シンポジウム、マイクロエレクトロニクスショー展示会およびアカデミックプラザを東京ビッグサイトにて、JPCA Show 2009（電子回路工業会主催）および JISSO PROTEC2009(ロボット工業会主催)と共同で開催した。

マイクロエレクトロニクスショーは、例年通り、「最先端実装技術・パッケージング展」と題して開催した。出展社は 22 社、56 小間、来場者は延べ 94,324 人（登録者 12,974 名）と昨年より減少した。

最先端実装技術シンポジウムは、ナノテク粒子技術、MEMS、プリンテッドエレクトロニクス、光/無線インターコネクション、カーエレクトロニクス、パワーエレクトロニクス、3D 実装、部品内蔵配線基板、高速・高周波最適設計、実装信頼性の最先端実装技術に関して 30 件講演を行い、405 名の聴講者があった。

今期より大学などの研究機関の開発技術を紹介するアカデミックプラザを新たに学会主催で開催し、21 件の口頭発表およびポスター展示を行い、学会と産業界との融合を図った。

(3)「第 19 回マイクロエレクトロニクスシンポジウム」(組織委員長 福岡大学 友景肇教授（会長）)

2009.9.10～11、福岡大学にて開催した。講演 81 件（一般講演 79 件　招待講演 2 件）の発表があった。「SMT と半導体パッケージング技術の融合による三次元 SiP モジュール化」（J-SiP 株式会社　藤津隆夫　代表取締役社長）と「高密度実装技術に貢献するめっき技術」（関東学院大学　小岩一郎教授）の招待講演が行われ、総計 282 名が参加した。

(4)「第 24 回エレクトロニクス実装学会講演大会」(講演大会委員長 芝浦工業大学 須藤俊夫教授)

2010.3.10～12、芝浦工業大学豊洲キャンパスにて開催した。依頼講演 14 件、一般講演 173 件、ものづくりセッション講演 33 件、ポスター25 件が発表された。さらに、よこはま高度実装技術コンソーシ

アム(YJC)および YUVEC と共催で、学生・初学者向けのチュートリアルセッション(6 件)も実施した。
特別講演として、「実装技術とフレキシブル有機エレクトロニクス」(東京大学　染谷隆夫教授)と「超高周波・超低電力アナログ・RF・LSIーミリ波・医療・環境などの新分野開拓に向けて-」(東京工業大学　松澤昭教授)の 2 件が講演された。発表件数は過去最高と多く、参加者数は 734 名と昨年を大きく上回った。

3. 調査・研究活動（定款第 4 条第 2 号関係）

(1) ワークショップの開催

①関西ワークショップ 2009

テーマを「ピンチをチャンスに！！　実装技術からの新ビジネス発掘」として、コープ・イン・京都で 2009.7.10 に開催した。特別講演として「08 年後半以降の環境激変の要因分析と今後の展望」(UBS 証券　後藤文人氏)、「大変革期を迎える半導体産業・パッケージング産業」(日本シーエムケイ株式会社　猪川幸司氏)2 件が講演された。ポスター18 件の発表があり、参加者は 64 名であった。

②2009 ワークショップ(修善寺)

メインテーマを「新産業創出の鍵を握る実装イノベーション」、サブテーマを「付加価値創出とローコスト化への挑戦ブレークスルーへの挑戦」として、ラフォーレ修善寺にて、2009.10.29～30、1 泊 2 日で開催した。特別講演として「三次元実装・モジュール技術が導く新たなビジネスモデル」(エー・アイ・ティ　加藤凡典氏)、「宇宙ステーションと科学技術研究　～なぜ、我々は宇宙に税金を使うのか?～」(日本工業大学　先端材料技術研究センター　三好和寿教授)の 2 件が講演された。ポスター発表は 28 件、参加者は 51 名であった。

(2) 技術委員会主催の開催行事

①材料技術委員会公開研究会(200912.8 国立オリンピック記念青少年総合センター)

テーマ「エコ時代が求める実装材料」　講演 8 件、参加者 100 名。

②電磁特性技術委員会サマーセミナー(2008.8.28　拓殖大学文京キャンパス)

テーマ「あなたならどうする？　低コスト、高速高周波、EMC 設計―プリント配線板、フレキ基板、EBG応用など―」 講演 9 件、参加者 123 名。

(3) 公開研究会の開催

①システム Jisso-CAD/CAE研究会(回路・実装設計技術委員会)

・第 1 回公開研究会(2009.6.4　東京ビッグサイト)

テーマ「チップ・パッケージ・ボード設計のための CAE」 サブタイトル「熱およびパワーインテグリティ問題と対応策」講演 5 件、参加者 90 名。

・第2回公開研究会(2009.12.1 回路会館)

テーマ「システム実装を支える設計・シミュレーション技術」 サブタイトル「パワーインテグリティを中心とした設計・シミュレーションの課題と対応策」講演 5 件、 参加者 51 名。

②超高速高周波エレクトロニクス実装研究会(電磁特性技術委員会)

・第 1 回公開研究会(2009.5.20　回路会館)

ミリ波プリント基板測定、高速伝送軽量化 FPC 他に関する講演 5 件、参加者 53 名。

・第 2 回公開研究会(2009.7.31　マホロバマインズ三浦)

チュートリアル＆ディスカッション 6 件、次世代プリント板実装の電気特性他に関する発表 4 件、参加者 74 名。

・第 3 回公開研究会(2009.11.6　回路会館)

結合線路、差動線路、EBG 構造他に関する講演 6 件、参加者 46 名。

③マイクロ・ナノファブリケーション研究会(配線板製造技術委員会)

・第 7 回公開研究会(2009.7.13　回路会館)

テーマ「マイクロ・ナノファブリケーションを支える材料・プロセス技術」　講演 5 件、参加者 65 名。

・第 8 回公開研究会(2009.9.30　回路会館)
テーマ「次世代電子回路基板のマイクロ・ナノファブリケーション技術」 講演 4 件、参加者 74 名。
・第 9 回公開研究会(2009.12.16　回路会館)
テーマ「次世代半導体パッケージのマイクロ・ナノファブリケーション技術 」講演 3 件、参加者 63 名。

④EPADs研究会(配線板製造技術委員会)
・第 1 回公開研究会(2009.6.30　回路会館)
テーマ「部品内蔵基板と実用化を支える要素技術」 講演 6 件、参加者 85 名。
・第 2 回公開研究会(2009.9.3　回路会館)
テーマ「進化する3次元実装／部品内蔵技術」 講演 5 件、参加者 110 名。
・第 3 回公開研究会(2009.11.25　回路会館)
テーマ「進化続ける3次元実装／部品内蔵技術」 講演 5 件、参加者 94 名。
・第 4 回公開研究会(2010.2.25　回路会館)
テーマ「部品内蔵基板とこれを支える実装材料技術」 講演 6 件、参加者 70 名。

⑤次世代配線板研究会(配線板製造技術委員会)
・第 1 回公開研究会(2009.10.26　回路会館)
テーマ「次世代配線板の姿を探る」 講演 5 件、参加者 67 名。

⑥エレクトロケミカル(イオン)マイグレーション評価法研究会(信頼性解析技術委員会)
・第 1 回公開研究会(2009.6.5　東京ビッグサイト)
テーマ「高密度プリント配線板絶縁性の加速試験法の研究―表面パターンとスルーホール間のエレクトロケミカルマイグレーション(ECM)による絶縁劣化の評価結果とその考察―」
講演 8 件、参加者 96 名。

⑦錫ウィスカ研究会(信頼性解析技術委員会)
・第 1 回公開研究会(2009.12.2　回路会館)
テーマ「ウィスカ解析技術とその発生機構」
講演 5 件、参加者 48 名。

⑧先進実装技術研究会(電子部品・実装技術委員会)
・第 1 回公開研究会(2009.6.25　横浜国立大学　よこはま高度実装技術コンソーシアム協賛)
テーマ「転換期にある電子機器業界の向かうべき方向/実装設計技術最前線」 講演 3 件　参加者 68 名。
・第 2 回公開研究会(2009.6.26　家の光会館　日本溶接協会共催)
テーマ「微細はんだ接合部の部分はんだ付け/実装技術最前線の紹介」講演 9 件、参加者 80 名。(電子部品技術研究会共催)
・第 3 回公開研究会(2009.10.26　横浜国立大学　よこはま高度実装技術コンソーシアム協賛)
テーマ「JEITA発行 2009 年度版　日本実装技術ロードマップ」 講演 6 件、参加者 65 名。
・第 4 回公開研究会(2009.12.7　回路会館)
テーマ「マイクロ接続技術の進化」 講演 5 件、参加者 52 名。
・第 5 回公開研究会(2010.2.26　回路会館)
テーマ「JEITA発行 2009 年度版　電子部品技術ロードマップ」 講演 9 件、参加者 80 名。(電子部品技術研究会共催)

⑨電子部品研究会(電子部品・実装技術委員会)
・公開研究会(2009.8.21　回路会館)
テーマ「最新の電子・機構部品技術、モジュール技術」 講演 5 件、参加者 41 名。

⑩検査の立場からみた DFT 研究会(検査技術委員会)
・第 1 回公開講演会(2009.11.20　国立オリンピック記念青少年総合センター)
テーマ「『見えない、触れない』部品の検査」 5 社の事例発表、参加者 52 名。

⑪光回路実装技術研究会(光回路実装技術委員会)

・第 39 回 OPT 公開研究会(2009.6.19　回路会館)
テーマ「光エレクトロニクス技術の最新情報」　講演 4 件、参加者 40 名。
・第 40 回 OPT 公開研究会(2009.9.4　回路会館)
テーマ「光インターコネクションの最新動向と車載応用」 講演4件、参加者 80 名。
・第 41 回 OPT 公開研究会(2009.11.26　回路会館)
テーマ「光接続・結合技術と光モジュール技術の最新動向」 講演 4 件、参加者 68 名。
・第 42 回 OPT 公開研究会(2010.1.14　回路会館)
テーマ「光実装に求められる標準化」　講演 4 件、参加者 50 名。

⑫環境配慮設計技術研究会(環境調和型実装技術委員会)
・第 1 回公開研究会(2009.6.4 東京ビッグサイト)
テーマ「環境調和技術の未来Ⅱ―新たに始まる環境ビジネス―」　講演 6 件、参加者 162 名。
・第 2 回公開研究会(2010.1.20　回路会館)
テーマ「再生可能エネルギーへの転換－我々は如何に対応するか?!」講演 6 件、参加者 43 名。

4. 普及・啓発活動（定款第 4 条第 3 号関係）

(1) PWB 製造教育講座

①PWB 製造・初級コース(2009.5.28～29　回路会館)
新入社員、営業部門向けに広い技術分野にまたがるプリント配線板について、基礎知識を修得することを目標とした教育講座を実施。受講者 9 名。

②PWB 製造・中級コース(2009.6.24～26　回路会館)
入社2～3年目の社員やプリント配線板のユーザーに基板の製造工程を修得させることを目標とし副題を「要素技術講座」として、穴あけから仕上げ検査・メンテナンスまでの教育講座を実施。受講者 11 名。

③PWB 製造・上級コース(2009.7.30～31　回路会館)
入社4～5年目の社員向けにプリント配線板の製造品質不良対策や新規技術を修得することを目標とした教育講座を実施。受講者 8 名。

(2)実装技術教育講座

①実装技術入門講座(2009.5.13～14　回路会館)
営業マンや新入社員向けに配線板の材料と実装に適する回路設計、電子部品の種類と実装形態の変遷など基礎的なレベルの講義に、簡単な電子機器の組み立て、はんだ付けなどの実習を加えて「実装技術」を修得することを目標とした教育講座を実施。受講者 7 名。

②実装技術総合講座(2009.10.15～16　回路会館)
企業で実装技術に携わる中堅技術者やこれから実装技術にかかわる異分野の技術者を対象とした講座を実施。受講者 21 名。

(3) 先端実装技術セミナー

①第 50 回定例セミナー(2009.11.11　回路会館)
テーマ「エレクトロニクスを支えるめっき最前線」
基調講演「エレクトロニクスを支えるめっき技術」(株式会社日立製作所　赤星晴夫氏)。特別講演「界面微細構造制御による金属めっき 膜/ポリイミド間の接着力の改善」(甲南大学　赤松謙祐准教授)その他講演 4 件、参加者 34 名。

②第 51 回定例セミナー(2010.2.23　回路会館)
テーマ「カーエレクトロニクス」
基調講演「サステイナブルモビリティー社会の実現に向けた自動車用パワーエレクトロニクス」(トヨタ自動車株式会社　原雅史氏)、特別講演「高温鉛フリーはんだ開発の現状」(大阪大学　菅沼克昭教授)。その他講演 3 件、参加者 55 名。

③JIEP 特別講演会(2010.1.18　回路会館)
テーマ「特許庁による“多層プリント配線基板に関する特許出願技術動向調査”報告

講演 2 件、参加者 72 名。

5. 情報収集および提供活動（定款第 4 条第 4 号関係）

(1)「エレクトロニクス実装学会誌」の発行

①学会誌を 7 回発行（Vol.12 No.3～7 および Vol.13 No.1～2）。

②会員の技術・研究活動の成果として発表される研究論文、総合論文、速報論文、技術論文、解説等を学会誌に掲載し、エレクトロニクス実装の研究と技術に関する最新の情報を会員に提供した。

(2) 英文論文誌の発行

論文数 26 件を掲載した英文論文誌 Transactions of The Japan Institute of Electronics Packaging Vol.2を 2009.12 に発行し、学会活動の国際化に貢献した。

(3)韓国語翻訳転載

当学会会誌の解説論文および技術論文について、雑誌「表面実装技術」（韓国 尖端社）に翻訳転載する契約を締結し、国際普及を促進した。Vol.12 No.1 から開始し、25 件の論文が転載された。

(4)電子ジャーナル化

当学会誌のVol.1～11 までと前身会誌（サーキットテクノロジ、回路学会誌、HYBRIDS、SHM 会誌）については科学技術振興機構（JST）が運用する電子アーカイブ（電子蔵書）に掲載した。また、Vol.12(2009 年発行)以降の学会誌についても、同じくJSTが運用する電子ジャーナル J-Stage に掲載し、当学会の活動の国際普及と会員サービスの充実を図った。

6. 内外機関等との交流・協力活動（定款第 4 条第 5 号関係）

(1) IMAPS との連携活動

①IMAPS の Affiliate 会員制度は継続することになり、今期 69 名が会員登録した。

②WLC-ALC（World Liaison Committee-Asia Liaison Committee）を 2009.4.14 に開催し、アジア並びに欧米の委員との情報交換を行った。

(2)国際会員の増強

当学会の国際的なプレゼンスを高めるために、英文論文誌の発行、韓国語翻訳転載のほかに、国際会員を積極的に受け入れるため、海外会員番号制度と専用申込書を整備した。

(3) JPCA Show2009/JISSO PROTEC2009 とのコラボレーション

例年、電子回路工業会と同時開催している JPCA Show/マイクロエレクトロニクショーに、ロボット工業会の JISSO PROTEC 展も加えて、3 団体の同時開催展示会を 2009.6.3～5、東京ビッグサイトにて開催した。また、最先端実装技術シンポジウム、アカデミックプラザおよび公開研究会 2 件(環境配慮設計技術研究会、システム Jisso-CAD/CAE研究会)を併設開催し、産業界との連携活動を行った。

(4) 関連学協会の各種事業に協賛など

1. 高温学会 “阪大接合科学研究所特別講演・研究会” 2009.7.17～18 大阪大学（協賛）
2. 精密工学会 “動的画像処理実利用化ワークショップ DIA2010” 2010.3.4～5 山梨大学甲府キャンパス（協賛）
3. 電子情報通信学会 “Microwave Workshops & Exhibition 2009” 2009.11.25～27 パシフィコ横浜 （協賛）
4. 電子情報技術産業協会 “「2009 年度版日本実装技術ロードマップ／プリント配線板編」詳細解説セミナー” 2009.7.27 回路会館 （協賛）
5. 大阪大学先端科学ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀ “国際シンポジウム「ECO-MATE2011」” 2011.11.28～30 大阪（ホテル阪急エクポパーク）（協賛）
6. 溶接学会マイクロ接合研究委員会 “Mate2010” 2010.2.2～3 ワークピア横浜 （協賛）
7. 有機テクノロジー実行委員会 “オルガテクノ 2009” 2009.11.10～11 東京（ベルサール八重洲）（協賛）
8. 腐食防食協会 “第 50 回技術セミナー「非鉄金属材料の防食技術と使いかた」” 2009.9.11 東京工業大学百年記念館(協賛)

9. 表面実装協会関西支部 “平成 21 年度第 2 回表面物性研究会” 2009.10.12 大阪鍍金会館(協賛)
10. 表面実装協会関西支部 “第 11 回関西表面実装技術ﾌｫｰﾗﾑ” 2009.12.1-2 甲南大学(協賛)
11. 色材協会 “第 6 回色材IT講座” 2009.11.25-26 日本大学工学部(協賛)
12. 神奈川科学アカデミー “KAST 教育講座「製造現場で考える環境規制」” 2009.10.29～12.11(5 回)川崎市産業振興会館かながわｻｲｴﾝｽﾊﾟｰｸ (後援)
13. 時計学会 “2009 秋季研究会” 2009.11.6 中央大学理工学部 (協賛)
14. 腐食防食協会 “第 35 回 腐食防食協会入門講習会” 2009.11.26-27 東京工業大学百年記念館 (協賛)
15. 日本印刷学会 “2009 年度E＆S研究会セミナー“スクリーン印刷のフレキシブルエレクトロニクスへの応用” 2009.12.17 日本印刷学会会館 (協賛)
16. 日本接着学会関西支部 “講演会「エレクトロニクス分野における接着・接合」” 2009.12.9 大阪国際 YMCA 文化センター (協賛)
17. IEEE CPMT Japan Society “2nd International IEEE Workshop on Low Temperature Bonding for 3D Integration” 2010.1.19-20 東京大学 弥生講堂 (協賛)
18. 神奈川科学アカデミー “KAST 教育講座「めっき技術の尖端と新展開」” 2009.10.29～12.11(5 回)川崎市産業振興会館かながわｻｲｴﾝｽﾊﾟｰｸ (後援)
19. 日本材料学会 “腐食防食部門委員会 第 272 回例会” 2010.1.27 パナソニック厚生年金基金松心会館(大阪) (協賛)
20. 大阪大学産業科学研究所 “ナノサイエンス・デバイスワークショップ「微細はんだ付け部のエレクトロマイグレーション」” 2010.3 上旬 大阪大学産業科学研究所(協賛)
21. 応用物理学会 “SSDM2009(国際固体素子・材料コンファレンス)” 2010.9.22-24 東京大学本郷キャンパス(協賛)
22. 日本能率協会“TECHNO-FRONTIER2010” 2010.7.21-23 東京ビッグサイト(協賛)
23. 電気学会 “平成 22 年電子・情報・システム部門大会” 2010.9.2～3 熊本大学工学部 (協賛)
24. NPO 法人サーキットネットワーク “C-NET 定期講演会” 2010.3.19 回路会館 (協賛)
25. 粉体粉末冶金協会 “平成 22 年度春季講演大会 企画セッション『高機能電子部品材料プロセスとその応用』” 2010.5.25-27 早稲田大学国際会議場 (協賛)
26. 表面技術協会 “将来めっき技術検討部会第一回例会ワークショップ” 2010.4.20 明電舎大崎会館 (協賛)
27. 電気化学会 “第 74 回半導体・集積回路技術シンポジウム” 2010.7.8-9 早稲田大学 (協賛)
28. 電気学会 “第 27 回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム” 2010.10.14-15 島根県産業交流館 (後援)
29. 日本時計学会 “2010 年春季研究会「テーマ:緊急地震速報と地震防災」” 2010.4.23 中央大学理工学部 (協賛)
30. 日本能率協会 “テクノフロンテア 2010「2010 熱設計・対策技術シンポジウム、」「2010EMC/ﾉｲｽﾞ対策技術シンポジウム」 ”2010.7.21～23 東京ビッグサイト (協賛)
31. 精密工学会 “ViEW2010「ビジョン技術の実利用ワークショップ」” 2010.10.9-10 パシフィコ横浜 (協賛)

7. 地域交流活動の促進(定款第 4 条第 6 号関係)

(1) 関西支部における各種事業の開催

①若手研究会セミナー(1)(2009.8.28 大阪大学)

テーマ「溶接・接合技術の基礎と今後の展望」で 2 件の講演

・“鉛フリーはんだ接合について” 大阪大学接合科学研究所 竹本正教授

・“樹脂接合について” 関西大学 越智光一教授

②若手研究会セミナー(2)(2010.1.29 コープイン京都)

テーマ:「不具合を予測する信頼性評価技術」

・“商品とお客様との対話から考える信頼性評価技術」元オムロン株式会社　伊藤貞則氏

・“シミュレーション技術を利用した電子実装部の定量的信頼性評価”京都大学　池田徹准教授

・“電子部品の加速試験と寿命予測解析”パナソニック電工株式会社解析センター　本山晃氏

③技術講演会(2010.2.19　大阪大学)

テーマ:「最先端実装技術動向～ローコスト化への挑戦～」

・“無電解バリア及び無電解銅めっきを用いた高アスペクト比 STV の形成技術”、関西大学　新宮原正三教授

・“自己集合性を利用したはんだ接合技術”　パナソニック株式会社　辛島靖治氏

・“部材の変化に追従したボンディング技術”　株式会社新川　萩原美仁氏

・“はんだ粒子含有ペーストを用いた実装技術”　パナソニックファクトリーソリューションズ株式会社　圓尾弘樹氏

④欧州環境規制セミナー(2009.7.23、大阪産業創造館　イベントホール)(大阪産業創造館との共催)

“欧州環境規制の動向”　日本電子回路工業会　青木正光氏

“鉛フリー実装の信頼性課題と動向”大阪大学産業科学研究所　菅沼克昭教授

⑤大阪大学産業科学研究所と共催のワークショップ「Nano Science and Device Workshop: Lead-Free Interconnect Technologies for High Reliability」

・“Lead Free Solder Joints / Requirements for Life-Time Identification”　Siemens AG　Prof. Albrecht

・“High Reliability and High Temperature Lead Free Solder for Car”　住金属工業株式会社　上島稔氏

・“Solder Electromigration in Lead-Free Flip Chip Joint System”　京セラ SLC テクノロジー株式会社　山中公博氏

・“Prestrain to Restrain Electromigration“　Institute of Metal Research Chinese Academy of Science　Dr. Zhang

(2) 九州支部における活動

福岡大学で開催した MES2009(2009.9.10-11)を支部活動の一部として支援した。

＊平成 22 年 3 月 31 日現在の会員数

正会員　　2695 名(前年同期比　212 名減)

学生会員　189 名(前年同期比　30 名増)

賛助会員　179 社(前年同期比　30 社減)